

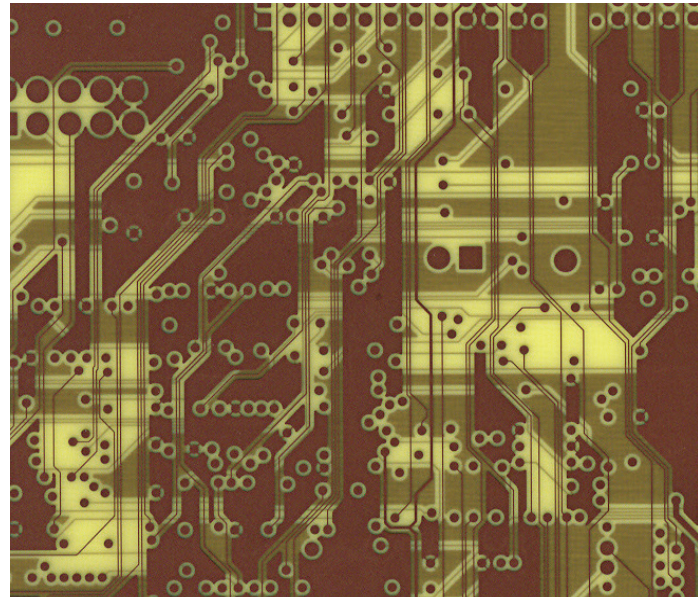
MultiBond MP

内层铜面压合前处理

无风险的棕化工艺 内层压和前处理的领导者

MacDermid Enthone 的MultiBond MP是内层压合的领先技术。专门设计用于电路板无铅焊接高温的流程。由于其优秀的化学特性，非常适合做为黑化的替代方案，与所有现有设备兼容。MacDermid Enthone的良好销售与售后服务支持您使用MultiBond MP。

MultiBond MP现在提供全球250多家客户并赢得信赖优越的内层压合工艺，更高铜容忍量且无铜泥。能够承受无铅加工所施加的严苛热应力，使多层板设计的可靠性得到改善。MultiBond MP系列作为我们棕化持续创新开发的一部分，MultiBond MP是多层板的最佳选择。针对行业领先的内层压合制程进行性能改良，同时降低整体成本，值得依靠一家公司 - MacDermid Enthone。



主要特性优点

- 用于压合多层板的最佳药液
- 全球超过250家客户
- 更高的铜容忍量可减少废液
- 与先进的介电材料搭配有良好的性能
- 与现有设备兼容

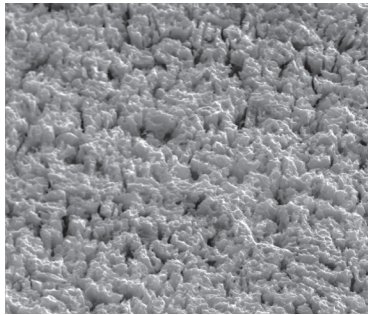


MultiBond MP

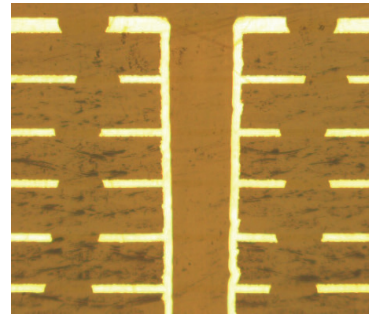
内层铜面压合前处理

多层板的卓越结合力

作为棕化工艺的市场领导者, MacDermid Enthone为您的应用设计了最好的化学品。MultiBond MP具有始终如一的高结合强度应用于高Tg环氧树脂, PTFE, 聚酰亚胺, BT和非卤化树脂。我们的技术专家可以帮助您的产品实现从有铅组装转进到无铅组装。优点包括用于控制阻抗的低咬蚀, 最小的侧蚀, 高铜负载 (> 40克/升) 和无铜泥。能够在提高生产产量的同时降低总体成本, MultiBond MP棕化是您的正确选择。



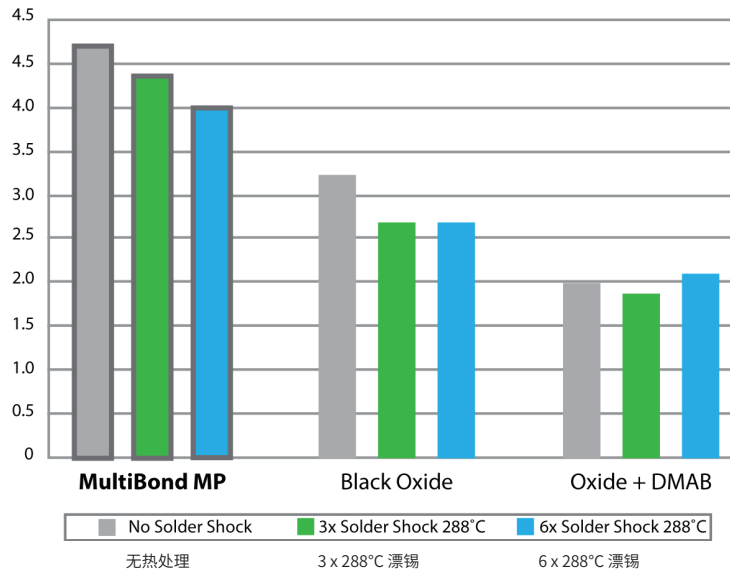
5000x SEM MultiBond MP 显示优良的表面型态作为树脂胶片结合。



组装重工模拟: 4x 多层板序列压合, 通过 3x 无铅回焊和3次260°C漂锡, 无暴板。

MULTIBOND MP拉力 VS 传统黑化

高Tg树脂 - 拉力测试 (Peeling)



macdermidalpha.com
October, 2019

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

© 2019 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.

CIRCUITRY SOLUTIONS